

# Tervetuloa O-johtavaan

Olemme ammattimainen piirilevyjen valmistaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus. Tuotevalikoima: yksi, kaksipuolinen, monikerroksinen piirilevy, joustava piirilevy ja MCPCB. Voimme tarjota nopean prototyypipalvelun - S / S 24 tuntia, 4-8 kerrosta 48-96 työtuntia.

[\(kuparipohjaisten piirilevyjen valmistajat\)](#)

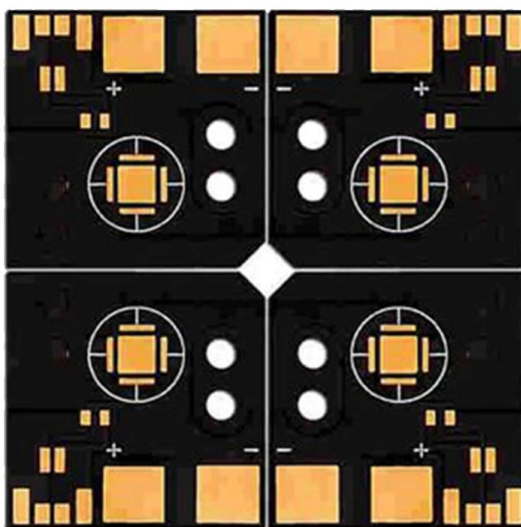
KUPARIYYTYSAIVAT MINIMAALISET .025 AVG, .020 MIN .. reikiä EI SAA kytkeä

Pakkaus värittömällä läpinäkyvällä kuplakalvolla, 25 kpl / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita kosteuden ilmaisinkortti yläpuolelle

Napsauta näitä saadaksesi lisätietoja:

## Tuotteen Kuvaus

PCB P / N	Q501805-A
Kerrosluku	2L
materiaali	Peruskeramiikka
Hallitus thk	0,50 mm
kupari thk	1 / 1oz
Pienin reiän koko	1.6mm
Reikien lukumäärä (kpl)	4
linja w / s	/
Impedanssisäätö. KYLLÄ / EI (Tol%)	N
Pinnan viimeistely	ENIG
Juotosmaskin silkkipaino	N / A
Yhden hallituksen koko	Himmeä X (mm): 109; himmeä Y (mm): 50
Panelisation	Himmeä X (mm): 109; himmeä Y (mm): 50; UPS: n määrä: 1
erityinen	N
Reititys / Lävistys	CNC



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

Piirilevy kuparit ytt isill  tukkumyynnill 

**Tiimimme**





sertifioinnit



201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component



ZPMV2.E490354  
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [online family of databases](#).  
Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED 4190354  
Fortune Building, Nanheng West Road  
Room 1313  
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

Type	Cond Width			SS/ DS/	Area Diam	Solder		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Min			Max	Temp			
Min	Edge	Thk	DS/	Thk	Temp	Class	DSR	I		
<b>Multi-layer (mass laminate) printed wiring boards.</b>										
<b>O-LEADING-401</b>										
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-
<b>O-LEADING-407</b>										
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI
<b>Multi-layer printed wiring boards.</b>										
<b>O-LEADING-408</b>										
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) min:1.35	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI
<b>Single layer printed wiring boards.</b>										
<b>O-LEADING-002</b>										
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI
<b>O-LEADING-003</b>										
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲
<b>O-LEADING-033</b>										
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI
<b>O-LEADING-205</b>										
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI
<b>O-LEADING-206</b>										
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI

\* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.  
Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

http://www.ul.com/onlinecertifications/201VZL430354/Wiring,Printed-Component



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**  
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new online certification platform, which provides a secure and efficient way to manage your certification data. The platform is designed to be user-friendly and easy to navigate, allowing you to view and manage your certification data from anywhere, at any time. For more information, please visit [www.sgs.com/certification](#).

Member of the SGS Group (SGS SA)

# Pakkaaminen ja toimitus

Pakkaustiedot	16-vuotias ammattimainen OEM-piirilevyjen valmistaja
Toimituksen yksityiskohdat	7-12 päivää



## Ohje

1. Kuinka O-Leading varmistaa laadun? [Heavy Copper Board valmistaja Kiina](#)

Korkea laatustandardimme saavutetaan seuraavilla tavoilla.

1. Prosessia ohjataan tiukasti ISO 9001: 2008 -standardien mukaisesti.

2. Laaja ohjelmistojen käyttö tuotantoprosessin hallinnassa

3. Maailmanmukaisimmat testauslaitteet ja työkalut. Esimerkiksi. Lentävä koetin, röntgentarkastus, AOI (automaattinen optinen tarkastaja) ja ICT (sisäinen testaus).

4. Dedicated laadunvarmistusryhmä vikatapausten analysointiprosessin kanssa

5. Henkilöstön jatkuva koulutus

2. Kuinka O-Leading pitää hintasi kilpailukykyisenä?

Viime vuosikymmenen aikana useiden raaka-aineiden (esim. Kuparin, kemikaalien) hinnat ovat kaksinkertaistuneet, kolminkertaistuneet tai nelinkertaistuneet; Kiinan valuutta RMB oli vahvistanut 31% enemmän kuin Yhdysvaltain dollari; Ja myös työvoimakustannuksemme nousivat merkittävästi.

O-Leading ovat kuitenkin pitäneet hinnoittelumme vakaana. Tämä johtuu kokonaan innovaatioistamme kustannusten vähentämisessä, jätteen välttämässä ja tehokkuuden parantamisessa. Hintamme ovat erittäin kilpailukykyisiä teollisuudessa samalla laatu tasolla.

Uskomme win-win-kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa. Kumppanuutemme on molemminpuolista hyötyä, jos pystymme tarjoamaan sinulle edun kustannuksissa ja laadussa.

3. Millaisia levyjä O-Leading voi käsitellä?

Yleiset FR4, korkean TG: n ja halogeenittomat levyt, Rogers, Arlon, Telfon, alumiini / kuparipohjaiset levyt, PI jne.

4. Mitä tietoja tarvitaan piirilevyjen tuotantoon?

Tiedot on parasta toimittaa Gerber 274-X-muodossa. Lisäksi Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP ja Eagle voidaan myös käsitellä.

5. Mikä on monikerroksisten piirilevyjen tyypillinen prosessivirta?

Materiaalin leikkaus → Sisäinen kuivakalvo → Sisäinen syövyttäminen → Sisäinen AOI → Monisidos → Kerrosten pinonkestäminen Painaminen → Poraus → PTH → Paneelien pinnoitus → Ulko kuivakuori → Kuviointi → Ulko syövyttäminen → Ulko AOI → Juotosmaski → Komponenttimerkki → Pinnan viimeistely → Reititys → E / T → Silmämääräinen tarkastus.